

インベスターズガイド2007  
東京エレクトロン デバイス株式会社

投資家の皆様へ

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

# INVESTORS GUIDE 2007



# TOP MESSAGE

2007年3月期は、2006年10月に東京エレクトロン(株)からCN(コンピュータ・ネットワーク)事業を承継したことに伴い、事業領域が拡大するなど当社にとって新たなスタートの年となりました。

業績面では、従来の半導体を中心とした電子部品事業は、産業機器向けの販売が堅調に推移いたしました。また、CN事業は、企業のIT投資が旺盛であったことからネットワーク機器やストレージ機器の販売が好調に推移いたしました。その結果、2007年3月期の連結業績は、売上高997億4千3百万円(前期比13.0%増)、経常利益32億4千5百万円(同23.4%増)、当期純利益18億7千6百万円(同22.1%増)となりました。

2008年3月期は、昨年後半からの半導体の在庫調整が上期まで続き下期に回復すると見込んでおり、当社の電子部品事業の業績も同様に下期回復を想定しております。また、CN事業に関しましては、企業のIT投資需要が引き続き好調に推移すると見込んでおります。こうした状況を踏まえ、連結業績見通しを売上高1,100億円(前期比10.3%増)、経常利益38億円(同17.1%増)、当期純利益22億円(同17.2%増)といたしました。

今後も、株主重視の経営に取り組んでまいりますので、倍旧のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



取締役会長 古垣 圭一(左)  
代表取締役社長 砂川 俊昭(右)

## CONTENTS

トップメッセージ	01
トピックス等	02
事業モデルと商品	03
商社ビジネス	05
開発ビジネス	09
マーケット情報	10
業績レビュー	11
財務諸表等	12
財務データ	15
会社概要・株式情報	18

## PROFILE

1965年	東京エレクトロン(株)で、電子部品の販売(フェアチャイルド社など)を開始
1990年9月	東京エレクトロン デバイス(株)で電子部品の販売を開始
1998年7月	東京エレクトロン(株)から電子部品に関する営業をすべて譲り受け、販売を開始
2003年3月	東京証券取引所市場第二部に上場
2004年1月	中国・上海に子会社の上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス上海)を設立
2005年1月	中国・香港に子会社の香港華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス香港)を設立
2006年10月	東京エレクトロン(株)から、コンピュータ・ネットワーク事業を継承し、販売を開始

### 将来の業績見通し等に関する注意事項

このインベスタースガイドは、2007年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想等の将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性等、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社Webサイトを御参照下さい。

## TOPICS

## ■ 営業拠点の拡充

2007年3月に松山出張所を開設し、国内の営業拠点は20箇所となりました。また、2007年1月に、東京エレクトロン デバイス香港・シンガポール支店を開設し、海外の営業拠点は4箇所となりました。今後も、お客様に密着した営業活動を実践してまいります。

## ■ CN(コンピュータ・ネットワーク)事業を承継

2006年10月に東京エレクトロン(株)から会社分割により承継したCN事業は、当社と共通した顧客を持ち、海外の最先端商品を取扱う商社ビジネスを展開しております。当社の業績規模拡大を通じて、企業価値の増大を目指してまいります。

## ■ 株式売出し

株式の分布状況の改善と流動性の向上を目的として、2007年3月に売出人を東京エレクトロン(株)とする当社株式の売出しを行いました。その結果、東京エレクトロン(株)の持株比率は73.6%から55.4%に減少いたしました。

## 中期経営計画・今期の活動方針

当社グループは、2011年3月期に売上高1,500億円、経常利益75億円を目指し、売上高経常利益率5%以上を目標とする中期経営計画を公表いたしました。



(注) 2006年3月期より連結決算を開始しており、2006年3月期以降は連結数値を記載しております。

また、2008年3月期の活動方針は以下の4点です。

## 1. CN事業の強化

成長性の高い事業分野であるCN事業を強化し、業績拡大に努めてまいります。

## 2. 海外事業展開の推進

伸長著しいアジアマーケットへの販売に注力し、海外事業の展開を推進してまいります。

## 3. 開発ビジネスの加速化

開発ビジネス(インレビウム事業)の売上高を24億円から、前期比34%増加の32億円に拡大させてまいります。

## 4. 産業機器分野への販売活動に注力

産業機器分野を当社の重点戦略マーケットとして位置づけ、お客様の開拓に注力してまいります。

## 配当方針

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置づけしており、継続的かつ安定的な配当実施を原則としております。また、成長に応じた利益還元につきましても重視し、業績連動型配当として、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安とすることを基本方針としております。

	2007年3月期		2008年3月期(予定)	
	中間	期末	中間	期末
1株当たり配当金(円)	3,000	3,000	3,300	3,300
配当性向	31.7%		31.8%	

## コーポレート・ガバナンス

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位及びステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。今後とも、経営の公正さと透明性を高めるために積極的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。

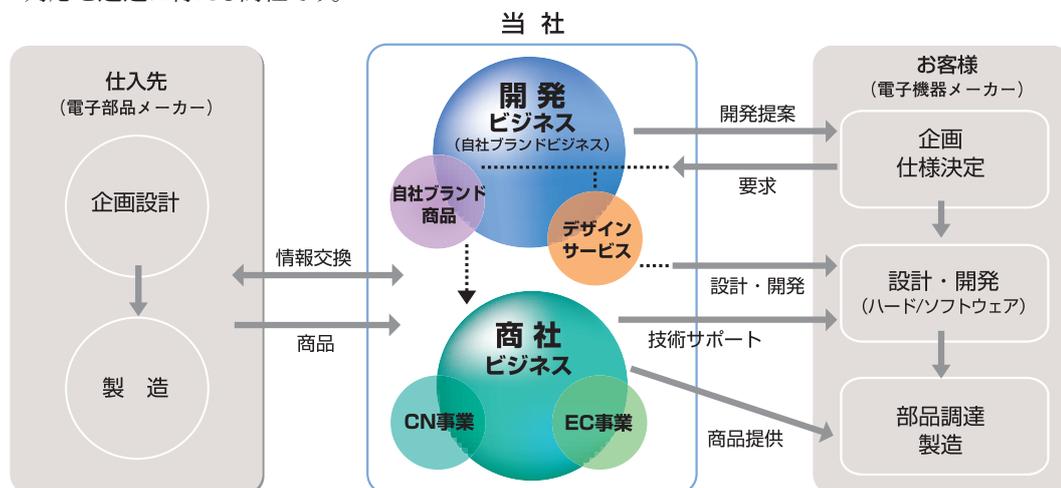
また、公正な経営の実現のためには、内部統制及びリスク管理体制強化も重要であると認識しており、法令や社会規範の遵守意識向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、具体的な行動の指針となる倫理行動基準を定めるとともに社内通報制度を導入、設置しております。



## 事業モデルと商品

当社は商社ビジネスと開発ビジネスからなる、新形態の技術商社です。急速な技術変化が求められるエレクトロニクス業界において、技術力・開発力・マーケティング力をベースに、付加価値の高い対応を迅速に行える商社です。

これにより、お客様が新商品の企画を行う初期の段階から、設計・開発、そして製造・量産に至るすべての段階で、常に最適なソリューションをタイムリーにご提供します。

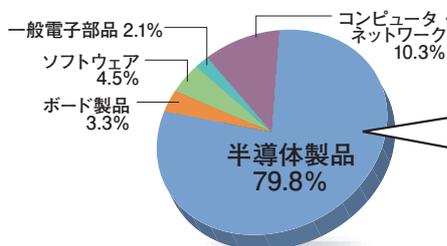


### 品目別構成

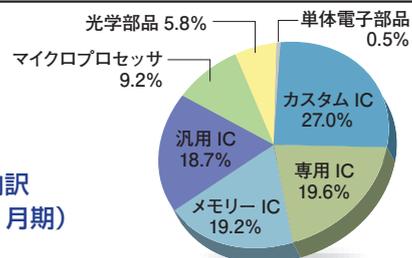
当社の商品構成は、半導体製品が約8割を占めています。半導体製品に関連するボード製品・ソフトウェア・一般電子部品も取り揃えて、お客様の多様なニーズに応えています。また、コンピュータ・ネットワークが当期から加わりました。

半導体製品の中では、カスタムIC、専用IC、汎用IC(アナログIC)など、技術サポートを必要とする付加価値の高い商品の比率が高くなっており、お客様から高い信頼を得ています。

#### ●品目別連結売上構成 (2007年3月期)

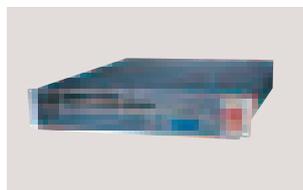


#### ●半導体製品内訳 (2007年3月期)



### 商品一覧

#### コンピュータ・ネットワーク



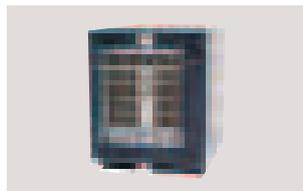
**ネットワークソリューション** インターネット接続機器 (負荷分散、セキュリティ)、企業向けネットワークシステム構築機器など

主な商品

●アプリケーショントラフィックマネージャ ●LANスイッチ ●ファイアウォール ●VPN アプライアンス ●ハードウェアセキュリティモジュール 他

主な仕入先 (アルファベット順)

●アラクサラネットワークス(株) ●エクストリーム ネットワークス社 ●F5 ネットワークス社 ●インバーバ社 ●インフォブロックス社 ●ジュニパーネットワーク社 ●エンサイファー社 ●セキュアコンピューティング社 他



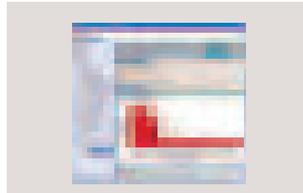
**ストレージソリューション** SAN (ストレージエリアネットワーク) スイッチ、SAN 接続機器、ストレージセキュリティ機器など

主な商品

●SAN ファブリックスイッチ ●バックアップアプライアンス ●テープライブラリ ●ファイバーチャネル ホストバスアダプタ ●クラスタ・ストレージ ●ストレージセキュリティアプライアンス 他

主な仕入先 (アルファベット順)

●プロレードコミュニケーションズシステムズ社 ●データドメイン社 ●エミュレックス社 ●株式会社日立製作所 ●アイシロン・システムズ社 ●ネオスケール システムズ社 ●クアンタム社 ●ストアウィズ社 ●シマンテック社 他



**ミドルウェアソリューション** データベース、ログ解析など

主な商品

●インメモリ・データベース ●組込みデータベース・エンジン ●ログ長期保存・分析・ツール 他

主な仕入先 (アルファベット順)

●日本オラクル(株) ●センセージ社 他

( *inrevium* のある品目は開発ビジネスが関わっている事を示しています。)

## 半導体製品

	<b>カスタム IC</b> お客様の仕様に応じて作られる固有 IC、ASIC や PLD が代表製品 <span style="float: right;"><i>inrevium</i></span>		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ASIC *<sup>1</sup></li> <li>● PLD *<sup>2</sup> (FPGA, CPLD)</li> </ul>	デジタル家電 / 携帯電話 / 交換機 / 計測器 / OA 機器 / 放送機器 / 医療機器 / 半導体試験装置	富士通株、ザイリンクス社
	<b>専用 IC</b> 通信用や画像処理用など、特定用途向けに作られた専用の IC <span style="float: right;"><i>inrevium</i></span>		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通信・ネットワーク用</li> <li>● 画像処理用</li> <li>● セキュリティ用</li> <li>● 周辺制御用</li> </ul>	デジタル家電 / OA 機器 / 交換機 / 通信端末 / プロジェクター / カーナビ / 監視カメラ	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通株、インターシル社、ビクセルワークス社、ザーリンク・セミコンダクター社
	<b>メモリー IC</b> 記憶専用の IC、書き込みと読み出しが可能な RAM、読み出しのみの ROM など		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フラッシュメモリ *<sup>3</sup></li> <li>● DARAM/SRAM</li> <li>● FRAM</li> </ul>	デジタル家電 / 携帯電話 / 交換機 / 計測器 / OA 機器 / 放送機器 / 医療機器 / 半導体試験装置 / カーナビ	富士通株、アイ・ディー・ティー社、ラムトロンインターナショナル社
	<b>汎用 IC</b> 色々な用途に共通して使用される IC、アナログ IC やロジック IC など		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アナログ</li> <li>● ロジック</li> </ul>	携帯電話 / 携帯端末 / パソコン周辺機器 / FA 機器 / カーナビ / OA 機器	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、テキサス・インスツルメンツ社
	<b>マイクロプロセッサ</b> コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能を持つ IC		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マイクロプロセッサ</li> <li>● マイクロコントローラ</li> <li>● DSP</li> </ul>	デジタル家電 / 携帯電話 / 交換機 / 計測器 / OA 機器 / 放送機器 / 医療機器 / 半導体試験装置 / カーナビ	AMD 社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通株、テキサス・インスツルメンツ社
	<b>光学部品</b> 電気を光に変換して使用する電子部品		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LED *<sup>4</sup></li> <li>● フォトカプラ *<sup>5</sup></li> <li>● 光ファイバー</li> <li>● IrDA *<sup>6</sup></li> </ul>	交換機 / 携帯電話 / FA 機器 / パソコン	アパゴ・テクノロジー社、ユーティナデバイス株
	<b>単体電子部品</b> 増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品		
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイオード *<sup>7</sup></li> <li>● トランジスタ</li> </ul>	携帯電話 / パソコン / OA 機器	オン・セミコンダクター社
<b>ボード製品</b> プリント基盤上に多数の IC や電源などを搭載した製品 <span style="float: right;"><i>inrevium</i></span>			
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CPU ボード</li> <li>● メディア処理ボード</li> <li>● インタフェースボード</li> <li>● 評価ボード</li> <li>● 組込みボード</li> </ul>	交換機 / サーバ / FA 機器 / 医療機器 / 計測器 / 半導体製造装置 / ロボット	ダイアロジック社、GE ファナックオートメーション社、株PFU
<b>ソフトウェア</b> コンピュータが理解できる方法で表現された処理手順 (プログラム) <span style="float: right;"><i>inrevium</i></span>			
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● OS</li> <li>● BIOS *<sup>8</sup></li> <li>● 開発ツール</li> </ul>	POS / 周辺装置 / FA 機器 / カーナビ / OA 機器 / 監視カメラ	アーデンス社、マイクロソフト社、フェニックステクノロジーズ社
<b>一般電子部品</b> 電源やコネクタ、ケーブルなど、半導体製品以外の電子部品			
	<b>主な商品</b>	<b>主な用途</b>	<b>主な仕入先 (アルファベット順)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パネル PC</li> <li>● LCD *<sup>9</sup></li> <li>● 電源</li> <li>● コネクタ</li> <li>● IC ソケット</li> </ul>	交換機 / FA 機器 / 医療機器	コーセル株、株デジタル

※1【ASIC】高性能が望めるが、開発期間が長くかかるカスタム IC。  
 ※2【PLD】プログラム可能な論理素子のカスタム IC。ASIC より短期開発が可能。  
 ※3【フラッシュメモリ】データを電気的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。  
 ※4【LED】電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。  
 ※5【フォトカプラ】電気信号を光に変換して伝達する素子。電気的な絶縁が利点。

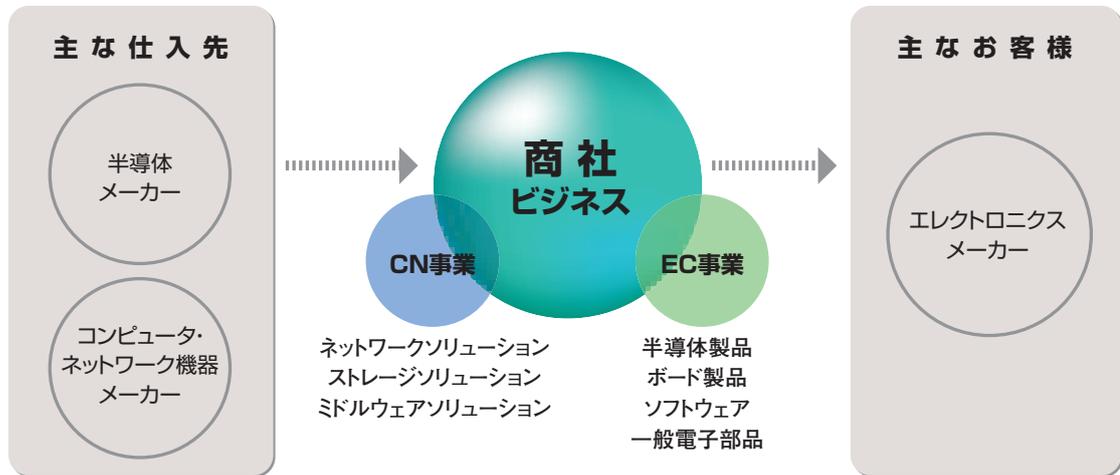
※6【IrDA】規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで使用。  
 ※7【ダイオード】電流を一方にのみ流す整流作用を持つ電子部品。  
 ※8【BIOS】キーボードやディスプレイなど基本的なデバイスを制御するソフトウェア。  
 ※9【LCD】液晶を使用したディスプレイ。ノート PC などに使用。



## 商社ビジネス

商社ビジネスは、半導体（集積回路・IC）を中心とした商品群を取扱うEC（電子部品）事業と、主にコンピュータ・ネット

ワーク製品を取扱うCN（コンピュータ・ネットワーク）事業で構成されています。



### CN（コンピュータ・ネットワーク）事業の特徴

- 主に米国からユニークで差別化が可能な最先端技術を探し出し、日本国内に投入
- 日本での販売促進、技術サポート、品質保証を当社が担う
- 技術的に難しい複合システムを構築しお客様へ提供
- 製品販売で利益を確保できる体制

### 注力分野

- F5 ネットワークス社を中心としたシステム構築ビジネスの推進
- 内部統制向けストレージ関連製品、ソフトウェア製品の拡販
- 保守運用サポートビジネスの拡大

### EC（電子部品）事業の特徴

- 独立系半導体商社として、長年の実績と信頼
- 主に米国の最先端商品を技術サポートとともにお客様へ提供
- 高付加価値半導体を中心とした商品構成
- 主なお客様は、大手電子機器メーカー
- 自社ブランド商品の開発などメーカー機能を持つ技術商社

### 注力分野

- アジア地域への半導体の拡販
- 自社ブランド商品の海外展開の推進
- 産業機器分野への半導体の拡販

## 商社ビジネス CN 事業

2006年10月に東京エレクトロン(株)から事業承継したCN事業はブロードバンド時代の企業間ビジネスを支えるITソリューションの販売と保守を主な事業としており、国内の通

信機器メーカーなどのお客様へ導入から運用・保守まで一貫したサポートを提供しています。

### 事業領域

#### ネットワークソリューション

##### 高速、高信頼のネットワーク

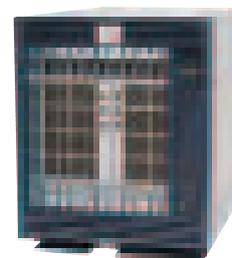
高度なセキュリティを実現するエンタープライズ向けネットワーク機器をはじめ、ネットワークサービスの高速化やセキュアな配信のためのソリューションを提供。また、外部からの侵入防御、情報漏洩防止など、ビジネスに求められる「高速で安全、止まらないネットワーク」を実現します。



#### ストレージソリューション

##### 効率的で安全なデータ管理を実現するストレージ

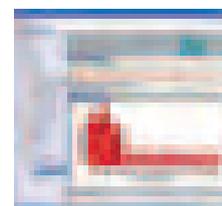
増え続けるデータを効率的に管理するSAN(Storage Area Network)およびストレージ周辺機器。大容量のデータを確実に保護するバックアップ・システム。さらに災害や犯罪からデータを保護するストレージ・セキュリティなどを提供します。



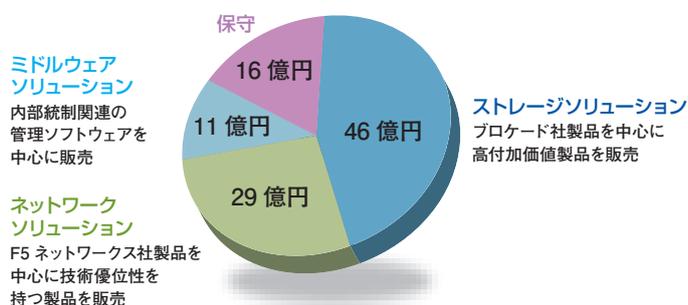
#### ミドルウェアソリューション

##### 性能向上や高信頼性化を実現するミドルウェア

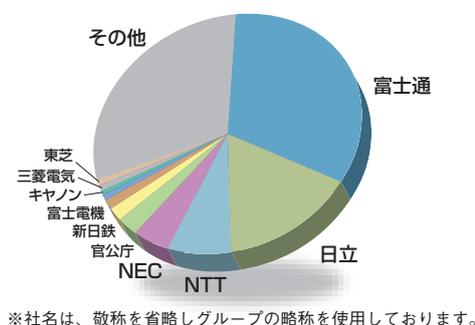
トランザクション性能が飛躍的に向上するインメモリ・データベースや、企業のセキュリティとコンプライアンス強化に威力を発揮するログ長期保存・分析のためのソリューションなどを提供します。



#### ● CN 事業売上構成 (2007年3月期)



#### ● お客様別売上構成 (2007年3月期)



### 品質保証体制

#### 製品のひとつひとつを支える、3つの品質

製品品質、サポート品質、技術品質、3つの品質チェックで、お客様、パートナー様の満足と信頼性の向上をめざします。たとえば、入荷検査、出荷調整、品質管理、品質改善、検証作業、データ解析を専門組織が対応。安心してご使用いただけるよう保守サービス、製品保証を用意しています。



## 商社ビジネス

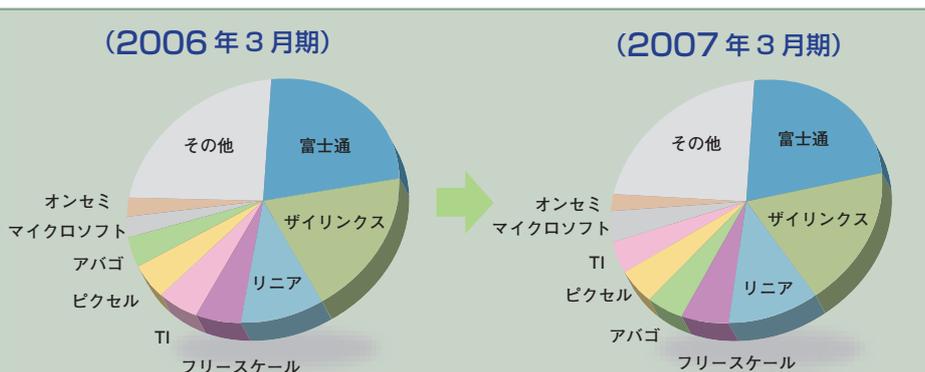
## ● EC 事業

世界中の電子部品メーカーに幅広くマーケティングを行い、最新の商品をラインアップしています。また、お客様に最適な提案を行うため、地域別や仕入先別の営業と、技術サポートを行うエンジニアが有機的に結合した体制で、きめ細かい

サービスをタイムリーに提供しています。さらに物流面では、最新のコンピュータシステムによる迅速かつ効率的なロジスティクスを構築しています。

## ● 仕入先の概要

## ● 仕入先別売上構成

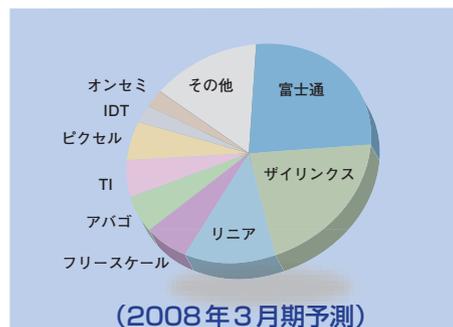


当社の仕入先は、海外の有力半導体メーカーを中心とした約45社です。メーカー別構成比では、第1位の富士通(株)が約23%、第2位のザイリンクス社が約18%、第3位のリニアテクノロジー社が約11%となっています。

## ● 2007年3月期 主要仕入先別売上増減要因

仕入先	増減率	要因	主要仕入先の紹介
富士通(株)	▲2%	民生機器向け減少	電子デバイス、コンピュータ、通信機器の各分野における世界のリーディング企業
ザイリンクス社	▲1%	通信機器向け減少も産業機器向け伸長	急成長中のプログラマブルロジックソリューションで世界のトップ企業
リニアテクノロジー社	10%	全ての分野で伸長	幅広い分野で利用されるアナログIC製品で、世界をリードする専門企業
フリースケール・セミコンダクタ社	6%	携帯電話基地向け伸長	組み込み用プロセッサの生産では世界有数の企業。幅広い半導体製品で世界をリード
アバゴ・テクノロジー社	16%	携帯電話向け伸長	光エレクトロニクスや無線通信分野で高い実績を持つ

## ● 半導体製品仕入先別売上構成



売上高上位の富士通(株)、ザイリンクス社、リニアテクノロジー社、フリースケール・セミコンダクタ社は引き続き安定した売上高で推移すると見込んでいます。

(上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。)

## ● 高付加価値の技術サポート

仕入先ごとに、専属のフィールド・アプリケーション・エンジニア (FAE) を配置し、企画・製造の各段階を通してきめ細かい技術サポートを行っています。お客様に対して新製品の技術説明や提案、技術問い合わせへの対応、不具合問題の解決、品質情報の提供などを行うと同時に、仕入先に対しても商品評価や技術的な調査への協力を行い、問題解決のできる技術商社として、双方から高い信頼を得ています。



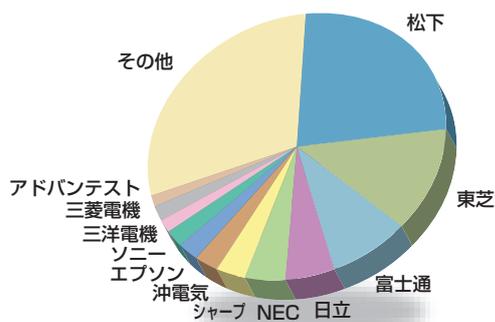
## ① お客様の概要と主な用途

当社のお客様は、電子機器メーカーを中心に1,000社以上にのぼります。売上高上位は、松下グループ、東芝グループ、富士通グループ、日立グループ、NECグループなど、国内の大手電子機器メーカーが満遍なく占めています。

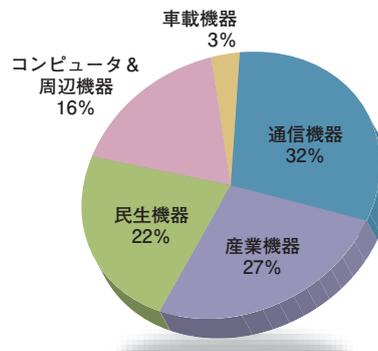
また、商品の用途別売上では、通信機器、産業機器、民生機器、コンピュータ&周辺機器など、幅広い分野で実績を上げており、特に産業機器の伸びが顕著です。

用途	主なアプリケーション
通信機器	インターネット接続機器 / LAN 機器 / 携帯電話 / 交換機 / 基地局
産業機器	セキュリティ監視機器 / 医療機器 / ロボット / 放送機器 / テスター / 半導体製造装置
民生機器	デジタルカメラ / デジタルビデオカメラ / 液晶テレビ / プラズマテレビ / DVD
コンピュータ & 周辺機器	プリンター / プロジェクター / POS / パソコン
車載機器	カーナビゲーション / カーオーディオ

●お客様別売上構成  
2007年3月期



●用途別売上構成  
2007年3月期



(注) 社名は、敬称を省略しグループの略称を使用しております。

## ● 海外ビジネス

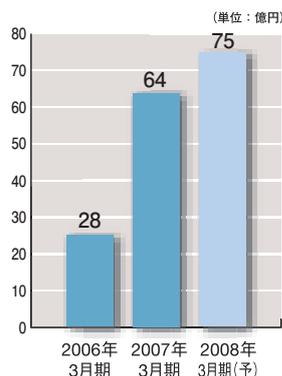
### ① アジア地域に、品質の高い半導体などの電子部品を提供

日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開。2005年に東京エレクトロン デバイス香港を設立以来、多言語対応、良質な物流サービスなどに注力し、上海、大連、シンガポールと拠点を増やしています。

営業開始から2年目の当期の売上高は、前期比36億円増加の64億円となりました。2008年3月期は、売上高75億円を予定しております。



●海外ビジネス売上高



東京エレクトロン デバイス香港  
(中央の高いビル内)



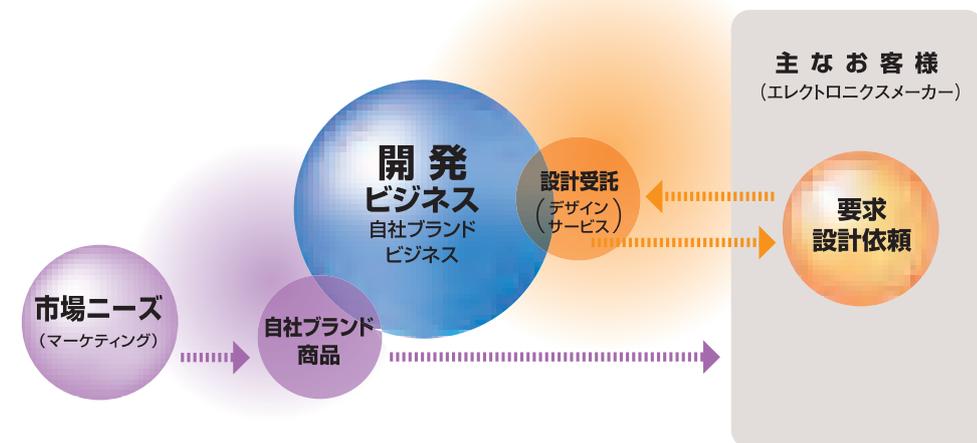
## 開発ビジネス

開発ビジネス(自社ブランドビジネス)は、お客様の要求に基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務(デザ

# inrevium

2004年6月、開発ビジネスについて自社ブランド「inrevium(インレヴィウム)」を命名しました。InreviumはIntellectual(知的な)、Revolutionary(革新的な)、ium(要素)などの単語の一部を組み合わせた造語です。当社が持つ情報・技術・サービスなどの商品化を通じて、お客様の抱える課題を解決し、事業活動に貢献していきたいとの強い意味が込められています。

インサービス)と市場ニーズに沿った商品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されています。



### ●インレヴィウム売上高推移



### 自社ブランド商品 (inrevium プロダクト)

長年培ってきた販売、設計・開発、マーケティング等の経験を活かして、お客様のニーズにフィットした自社ブランド商品を開発しています。

画像処理やメモリ制御技術、通信インタフェース技術など当社保有の技術を活用した商品、豊富な取扱商品と組み合わせる付加価値を高めた商品、大学や研究機関と共同で開発



した産学官連携商品、ターゲット市場を限定した汎用商品の4カテゴリーで、現在、60種類以上の商品・サービスを提供しています。

### 設計受託 (inrevium デザインサービス)

お客様の設計工数を削減すると同時に、経験豊富な専門家に任せることで、設計リスクの軽減や最新技術の活用、設備投資や維持費の低減などが容易に行え、しかも開発期間の短縮による商品の早期完成が可能になります。



### 設計開発センター (inrevium 開発センター)

1985年に開設された設計開発センターでは、豊富な設計・開発の経験と、常に最新の技術動向を先取りした設備の導入により、自社ブランド商品の開発やお客様の要求に基づくデザインサービスを、スピーディかつ効率的に実現し、新商品の市場投入を短期間に安価で行うことを支援いたします。現在、設計開発センターは日本の横浜と仙台、中国の上海と無錫の4箇所にあります。

また、この商品開発経験が、商社ビジネスの営業提案や技術サポートに活かされることにより、No.1技術商社ならではのシナジー効果を創出しています。



# マーケット情報

## ① 世界の半導体市場動向



世界半導体市場のドルベースでの伸び率は、2006年は2005年の緩やかな市場拡大(+6.8%)を上回り、年率では前年比+8.9%(2,477億ドル)となりました。その後2007年は+2.3%と伸長が足踏みするものの、2008年は+10.2%と回復し2009年には+5.2%と再び緩やかな成長を示すものと

予測されています。この結果、2006年から2009年までの年平均成長率は+5.8%となります。2007年の世界の半導体市場規模は2,535億ドル(30兆3千億円)、対前年58億ドル増となり、2006年に達成した過去最大の市場規模を更に続伸すると予測されています。

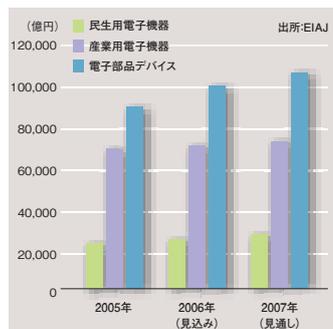
## ② 日本の半導体市場動向



日本の半導体市場伸び率は、円ベースで2006年のマイナス成長(-2.0%)に対し前年比+11.3%と回復しましたが、2007年は前年比+5.4%と緩やかな成長に留まるものと予測されています。その後2008年は前年比+7.0%、2009年は前年比+3.1%と緩やかな伸長を継続すると予測されていま

す。その結果、日本の半導体市場規模は、2006年は約5兆4千億円でしたが、2007年は約5兆6千9百億円、2008年は約6兆9百億円、2009年は約6兆2千7百億円となり、2006年から2009年までの年平均成長率は+5.1%となるものと予測されています。

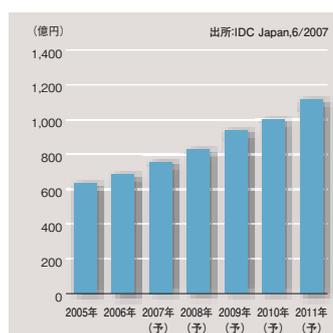
## ③ 日本の電子工業生産



2005年、3年ぶりにマイナスとなったわが国電子工業の国内生産は2006年、20兆2,815億円、前年比+6.5%と再びプラスに転じるものと見込まれています。これは、2004年の夏休み明けから調整局面だった生産が、内外景気の回復やサッカーワールドカップドイツ大会等が好材料となり、2005年の5月を底に回復基調に転じ、その後順調に推移したことによるものであります。しかしながら、2006年後半に入り、輸

出、設備投資は堅調なもの、個人消費に一服感も見えてきており、今後の動向が注目されます。2007年のわが国電子工業の国内生産は米景気が減速気味のため、前半、調整局面に向かう可能性を否定できないものの、デフレ脱却も着実に進んでおり、遅れていた賃金改善も徐々に進展し、個人消費の伸びが回復して行くと思われることから、21兆163億円、前年比+3.6%と2年連続増加するものと予測されています。

## ④ 国内ストレージソフトウェア市場売上実績および予測



2006年の国内ストレージソフトウェア市場は691億6,000万円で前年比+10.5%の高い成長を遂げました。企業の保有するデジタルデータの増大とその保護ニーズの高まりが市場を牽引し、ストレージソフトウェア全体の売上は2005年に比べて2桁成長となりました。国内ストレージソフトウェア

市場の2011年までの平均成長率は+9.6%と予測されています。国内企業にデータ保護を促す要因としては、IT依存度の高まりからくるデータ損失への懸念以外にも、CSR(企業の社会的責任)、内部統制、フォレンジック(データ証拠性確保)など多様化してきています。



## 業績レビュー

### ① 当期（2007年3月期）の業績報告

当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇懸念などの不安要素はあったものの、好調な企業業績を背景にして設備投資は増加し、また、雇用情勢の改善も進むなど景気は堅調に推移いたしました。

当社グループの参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、携帯電話は、多種多様な機能やサービスにより需要が喚起され堅調でありました。薄型テレビ（PDP・液晶）は、引き続き価格低下が進むなかで市場を拡大しました。また、産業機器分野や基地局などの通信インフラへの投資は、旺盛な設備投資意欲に支えられて増加し、企業向けにパソコン需要も堅調でありました。

このような状況のもと当社グループは、国内におきましては、産業機器分野を重点戦略マーケットと位置づけ、カスタムICや汎用IC（アナログIC）など、高度な技術サポートを要する高付加価値商品の販売に努め、また、開発ビジネスは、

設計受託業務の受注拡大、産業機器向け商品の開発に注力し、自社ブランド「インレビウム」商品の販売拡大に努めてまいりました。海外におきましては、連結子会社である東京エレクトロン デバイス香港がシンガポールに拠点を開設し、海外に生産拠点を展開する日系顧客のサポートの充実に努めてまいりました。

なお、当社グループは東京エレクトロン(株)よりコンピュータ・ネットワーク事業を承継し、2006年10月からネットワーク機器、ストレージ機器及びIT関連ソフトウェアの販売、保守サービスを開始し、事業領域を拡大いたしました。

この結果、当期の連結売上高は997億4千3百万円（前期比13.0%増）、経常利益は32億4千5百万円（前期比23.4%増）、当期純利益は18億7千6百万円（前期比22.1%増）となりました。

### ② 品目別概況

#### 半導体製品

79.8%

医療機器向けカスタムICや携帯電話基地局向けメモリICの販売が堅調であり、また、多機能プリンタ向け専用ICの販売が増加いたしました。しかしながら、民生機器向けカスタムICの需要減少や期後半から在庫調整の影響を受けたことにより、当期の連結売上高は、795億6千9百万円（前期比1.7%増）となりました。

#### ボード製品

3.3%

半導体試験装置向けボードコンピュータなどの拡販に努めましたが、一部商品の取扱いを終了したこともあり、当期の連結売上高は、32億6千4百万円（前期比21.7%減）となりました。

#### ソフトウェア

4.5%

POS端末向けOSの販売が好調であり、当期の連結売上高は、45億2千7百万円（前期比43.8%増）となりました。

#### 一般電子部品

2.1%

スイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネルPCなどの産業機器向けは堅調でありましたが、デジタルビデオカメラ用液晶モニターの取扱いを終了したことから、当期の連結売上高は、21億8百万円（前期比22.9%減）となりました。

#### コンピュータ・ネットワーク

10.3%

企業の内部統制やセキュリティに対する意識が向上するなか、設備投資意欲も旺盛であったことからネットワーク機器及びストレージ機器の販売が好調であり、当期の連結売上高は、102億7千2百万円となりました。なお、2006年10月より取扱いを開始したことから前期との比較は行っておりません。

### ③ 次期の見通し

今後の見通しにつきましては、原油価格高騰に伴う原材料価格の高止まりや世界経済の動向など不安要素はあるものの、景気は引き続き堅調に推移するものと予想されます。

当社グループが参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましては、昨年後半からの在庫調整の影響から脱し、期後半には本格的に回復するものと予想されます。

こうした状況のもと、2008年3月期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,100億円（前期比10.3%増）、営業利益40億8千万円（前期比15.5%増）、経常利益38億円（前期比17.1%増）、当期純利益22億円（前期比17.2%増）を見込んでおります。



# 連結財務諸表

## 連結貸借対照表

資産の部	前 期	当 期
	(2006年3月31日現在)	(2007年3月31日現在)
	千円	千円
<b>流動資産</b>	<b>34,749,840</b>	<b>43,387,749</b>
現金及び預金	798,658	1,142,667
受取手形及び売掛金	17,017,502	23,361,816
たな卸資産	15,816,970	16,888,548
繰延税金資産	282,897	482,330
未収消費税等	684,728	530,177
その他	157,356	988,878
貸倒引当金	△ 8,272	△ 6,670
<b>固定資産</b>	<b>2,339,127</b>	<b>3,341,910</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>723,203</b>	<b>1,019,858</b>
建物及び構築物	506,948	559,814
工具、器具及び備品	216,254	460,043
<b>無形固定資産</b>	<b>169,901</b>	<b>227,334</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,446,023</b>	<b>2,094,717</b>
投資有価証券	—	59,025
繰延税金資産	1,154,660	1,497,022
その他	291,692	543,766
貸倒引当金	△ 329	△ 5,097
<b>資産合計</b>	<b>37,088,968</b>	<b>46,729,660</b>

## 資産

資産総額は467億2千9百万円となり、前期比96億4千万円の増加となりました。これは主に、東京エレクトロン(株)から吸収分割により承継した事業にかかる売上債権、たな卸資産及び前渡金等が増加したことによります。

## 負債

負債総額は266億7千3百万円となり、前期比47億4千4百万円の増加となりました。これは主に、吸収分割に伴い承継した事業にかかる前受金、未払金、退職給付引当金等が増加したことによります。

負債の部	前 期	当 期
	(2006年3月31日現在)	(2007年3月31日現在)
	千円	千円
<b>流動負債</b>	<b>15,972,746</b>	<b>22,718,370</b>
買掛金	12,253,808	12,888,266
短期借入金	1,698,223	1,351,399
一年以内返済予定長期借入金	—	3,000,000
未払金	862,434	1,784,735
未払法人税等	550,619	999,943
賞与引当金	477,325	824,157
役員賞与引当金	—	26,000
その他	130,334	1,843,867
<b>固定負債</b>	<b>5,955,677</b>	<b>3,954,829</b>
長期借入金	3,000,000	—
退職給付引当金	2,658,781	3,615,122
役員退職慰労引当金	96,396	111,907
その他	200,500	227,800
<b>負債合計</b>	<b>21,928,424</b>	<b>26,673,199</b>
<b>資本の部</b>		
資本金	2,495,750	—
資本剰余金	2,054,850	—
利益剰余金	10,605,677	—
為替換算調整勘定	4,266	—
<b>資本合計</b>	<b>15,160,544</b>	<b>—</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>37,088,968</b>	<b>—</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本	—	20,054,514
資本金	—	2,495,750
資本剰余金	—	5,645,240
利益剰余金	—	11,913,524
<b>評価・換算差額等</b>	<b>—</b>	<b>1,945</b>
その他有価証券評価差額金	—	△ 115
繰延ヘッジ損益	—	△ 1,502
為替換算調整勘定	—	3,564
<b>純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>20,056,460</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>—</b>	<b>46,729,660</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 純資産

純資産総額は200億5千6百万円となり、前期比48億9千5百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加13億7百万円及び吸収分割に伴う新株の発行により資本準備金が35億9千万円増加したことによります。



# 連結財務諸表

## 連結損益計算書

科 目	前 期	当 期
	2005年4月1日から 2006年3月31日まで	2006年4月1日から 2007年3月31日まで
	千円	千円
売上高	88,290,003	99,743,143
売上原価	76,773,514	85,636,961
売上総利益	11,516,489	14,106,181
販売費及び一般管理費	8,416,409	10,575,028
給料手当	3,119,262	3,633,426
賞与引当金繰入額	478,470	826,577
役員賞与引当金繰入額	—	26,000
退職給付引当金繰入額	599,819	572,512
その他	4,218,857	5,516,512
営業利益	3,100,079	3,531,153
営業外収益	46,797	40,729
受取利息	1,151	2,495
受取配当金	5,204	5,675
ライセンス収入	15,000	—
セミナー開催収入	6,456	7,218
受取保険配当金	11,782	14,793
その他	7,202	10,546
営業外費用	516,327	326,335
支払利息	100,995	95,152
債権譲渡損	116,798	169,433
為替差損	292,091	51,449
その他	6,442	10,300
経常利益	2,630,550	3,245,547
特別利益	4,483	1,684
固定資産売却益	330	—
貸倒引当金戻入益	4,153	1,684
特別損失	2,390	5,951
固定資産売却損	—	102
固定資産除去損	2,390	5,849
税金等調整前当期純利益	2,632,643	3,241,280
法人税、住民税及び事業税	1,131,636	1,539,969
法人税等調整額	△ 36,277	△ 175,435
当期純利益	1,537,284	1,876,746

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前 期	当 期
	2005年4月1日から 2006年3月31日まで	2006年4月1日から 2007年3月31日まで
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,632,643	3,241,280
減価償却費	257,916	287,504
貸倒引当金の増減額	△ 4,153	△ 1,684
賞与引当金の増減額	45,714	346,763
役員賞与引当金の増減額	—	26,000
退職給付引当金の増減額	△ 6,017	70,069
役員退職慰労引当金の増減額	1,555	15,511
受取利息及び受取配当金	△ 6,356	△ 8,171
支払利息	100,995	95,152
為替差損益	△ 1,219	169
有形固定資産売却損益	△ 330	102
有形固定資産除却損	2,390	5,849
売上債権の増減額	4,215,344	△ 1,507,127
たな卸資産の増減額	△ 5,151,893	730,265
仕入債務の増減額	3,644,979	△ 649,981
未収消費税等の増減額	△ 318,746	154,550
その他	△ 365,989	78,671
小計	5,046,832	2,884,927
利息及び配当金の受取額	6,356	8,171
利息の支払額	△ 100,939	△ 95,020
法人税等の支払額	△ 1,021,910	△ 1,143,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,930,337	1,654,878
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 178,146	△ 150,304
有形固定資産の売却による収入	615	1,914
無形固定資産の取得による支出	△ 36,567	△ 63,854
投資有価証券の取得による支出	—	△ 59,220
貸付けによる支出	—	△ 600
その他	13,477	△ 129,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,621	△ 401,430
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	1,684,154	△ 350,173
長期借入金の返済による支出	△ 5,000,000	—
配当金の支払額	△ 552,000	△ 552,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,867,845	△ 902,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,317	△ 7,265
現金及び現金同等物の増減額	△ 128,810	344,009
現金及び現金同等物の期首残高	927,469	798,658
現金及び現金同等物の期末残高	798,658	1,142,667

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
2006年3月31日残高	2,495,750	2,054,850	10,605,677	15,156,277	—	—	4,266	4,266	15,160,544
当期変動額									
会社分割に伴う新株の発行		3,590,390		3,590,390					3,590,390
剰余金の配当（利益処分）			△ 276,000	△ 276,000					△ 276,000
剰余金の配当（中間配当）			△ 276,000	△ 276,000					△ 276,000
利益処分による役員賞与			△ 16,900	△ 16,900					△ 16,900
当期純利益			1,876,746	1,876,746					1,876,746
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					△ 115	△ 1,502	△ 702	△ 2,321	△ 2,321
当期変動額合計	—	3,590,390	1,307,846	4,898,237	△ 115	△ 1,502	△ 702	△ 2,321	4,895,916
2007年3月31日残高	2,495,750	5,645,240	11,913,524	20,054,514	△ 115	△ 1,502	3,564	1,945	20,056,460

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別財務諸表

## 個別貸借対照表

資産の部	当 期 (2007年3月31日現在)	負債の部	当 期 (2007年3月31日現在)
	千円		千円
流動資産	42,453,775	流動負債	21,892,164
現金及び預金	1,100,765	買掛金	12,654,137
受取手形	518,857	短期借入金	800,000
売掛金	22,788,128	一年以内返済予定長期借入金	3,000,000
商品	16,059,952	未払金	1,773,111
前渡金	714,957	未払費用	2,083
前払費用	88,119	未払法人税等	983,103
繰延税金資産	476,142	前受金	1,620,536
未収消費税等	530,177	預り金	76,678
その他	183,720	前受収益	79,186
貸倒引当金	△ 7,047	賞与引当金	816,347
		役員賞与引当金	26,000
固定資産	3,375,959	その他	60,980
有形固定資産	1,019,597	固定負債	3,954,829
建物及び構築物	559,814	退職給付引当金	3,615,122
工具、器具及び備品	459,783	役員退職慰労引当金	111,907
無形固定資産	221,811	その他	227,800
投資その他の資産	2,134,550	負債合計	25,846,994
投資有価証券	59,025	純資産の部	
繰延税金資産	1,497,022	株主資本	19,984,358
その他	578,503	資本金	2,495,750
資産合計	45,829,734	資本剰余金	5,645,240
		利益剰余金	11,843,368
		評価・換算差額等	△ 1,618
		その他有価証券評価差額金	△ 115
		繰延ヘッジ損益	△ 1,502
		純資産合計	19,982,740
		負債及び純資産合計	45,829,734

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別損益計算書

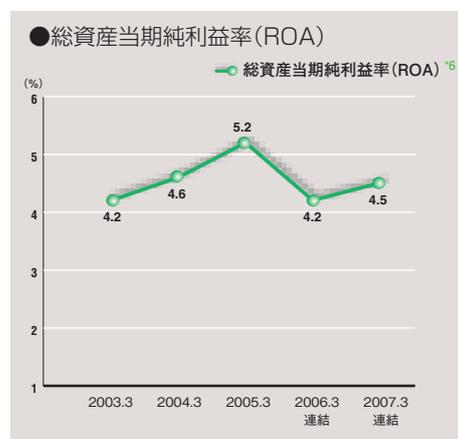
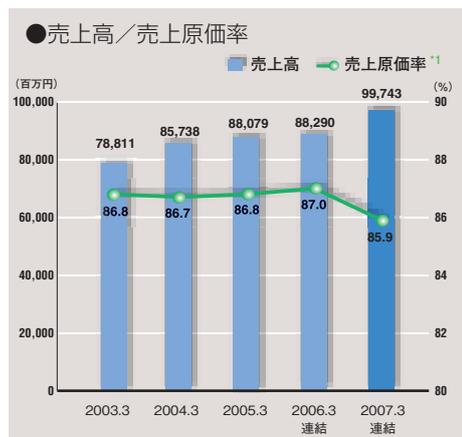
科 目	当 期 2006年4月1日から 2007年3月31日まで
	千円
売上高	97,194,143
売上原価	83,385,493
売上総利益	13,808,650
販売費及び一般管理費	10,424,729
役員報酬	139,800
従業員給料手当	3,445,325
従業員賞与	510,977
賞与引当金繰入額	814,741
退職給付引当金繰入額	572,512
減価償却費	286,180
研究開発費	100,881
その他	4,554,309
営業利益	3,383,920
営業外収益	43,692
受取利息	1,902
受取配当金	5,675
セミナー開催収入	7,218
受取保険配当金	14,793
その他	14,102
営業外費用	293,195
支払利息	52,600
債権譲渡損	169,433
為替差損	60,861
その他	10,300
経常利益	3,134,417
特別利益	1,547
特別損失	5,951
税引前当期純利益	3,130,013
法人税、住民税及び事業税	1,523,283
法人税等調整額	△ 172,290
当期純利益	1,779,020

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 財務データ

## 収益性



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2003.3	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2007.3 単体
売上高 (百万円)	78,811	85,738	88,079	88,290	99,743	97,194
売上原価率 (%) *1	86.8	86.7	86.8	87.0	85.9	85.8
営業利益 (百万円)	2,998	3,182	3,106	3,100	3,531	3,383
営業利益率 (%) *2	3.8	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5
経常利益 (百万円)	2,574	2,952	2,820	2,630	3,245	3,134
経常利益率 (%) *3	3.3	3.4	3.2	3.0	3.3	3.2
当期純利益 (百万円)	1,423	1,680	1,916	1,537	1,876	1,779
当期純利益率 (%) *4	1.8	2.0	2.2	1.7	1.9	1.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) *5	15.7	13.8	14.2	10.5	10.7	10.1
総資産当期純利益率(ROA)(%) *6	4.2	4.6	5.2	4.2	4.5	4.3

\*1. 売上原価率=売上原価÷売上高

\*2. 営業利益率=営業利益÷売上高

\*3. 経常利益率=経常利益÷売上高

\*4. 当期純利益率=当期純利益÷売上高

\*5. 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益÷期首・期末平均自己資本

\*6. 総資産当期純利益率(ROA)=当期純利益÷期首・期末平均総資産

## 効率性・安全性



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2003.3	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2007.3 単体
総資産 (百万円)	35,041	37,424	35,988	37,088	46,729	45,829
総資産回転率 (回) *1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4
棚卸資産 (百万円)	11,004	12,555	10,649	15,816	16,888	16,059
棚卸資産回転率 (回) *2	7.6	7.3	7.6	6.7	6.1	6.2
売上債権回転率 (回) *3	3.9	4.3	4.2	4.6	4.9	4.8
仕入債務回転率 (回) *4	12.8	11.0	9.4	7.4	6.8	6.8
流動資産 (百万円)	32,063	34,502	33,510	34,749	43,387	42,453
流動比率 (%) *5	249.8	254.3	211.8	217.6	191.0	193.9
負債総額 (百万円)	23,437	24,649	21,772	21,928	26,673	25,846
負債比率 (%) *6	202.0	192.9	153.2	144.6	133.0	129.3
純資産 (百万円)	11,603	12,775	14,216	15,160	20,056	19,982
自己資本比率 (%) *7	33.1	34.1	39.5	40.9	42.9	43.6

\*1. 総資産回転率＝売上高÷期首・期末平均総資産

\*2. 棚卸資産回転率＝売上高÷期首・期末平均棚卸資産

\*3. 売上債権回転率＝売上高÷期首・期末平均(受取手形+売掛金)

\*4. 仕入債務回転率＝売上原価÷期首・期末平均買掛金

\*5. 流動比率＝流動資産÷流動負債

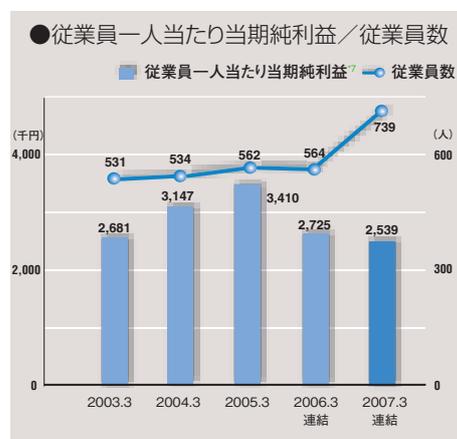
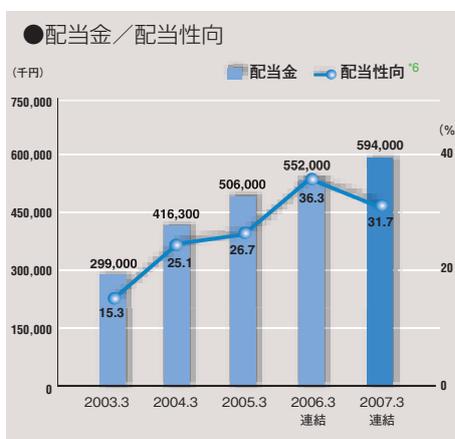
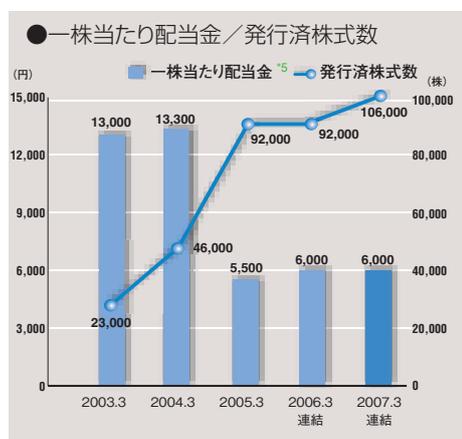
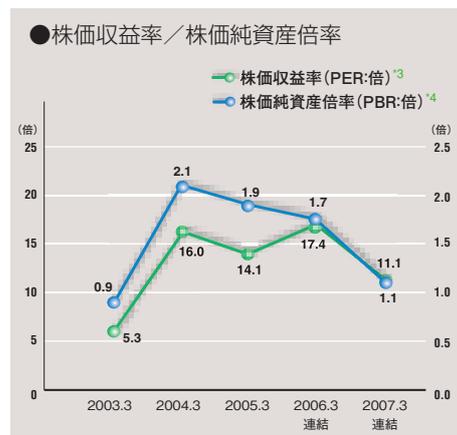
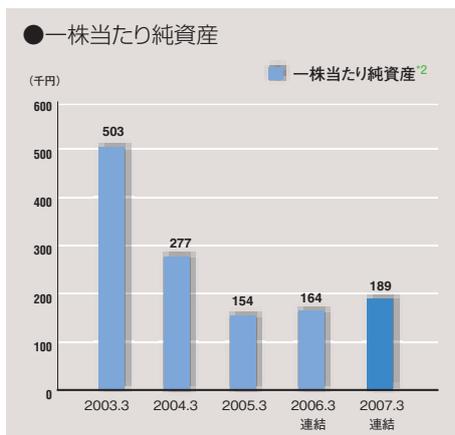
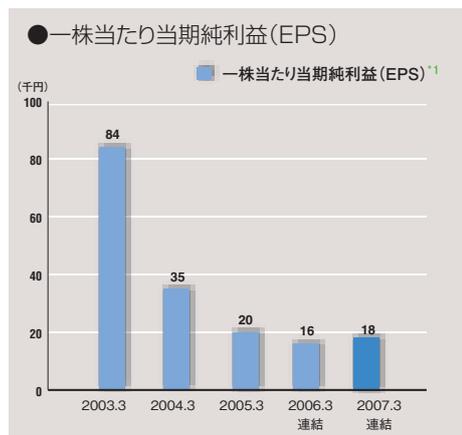
\*6. 負債比率＝負債÷株主資本

\*7. 自己資本比率＝株主資本÷総資産



## 財務データ

## その他の指標



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2003.3	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2007.3 単体
一株当たり当期純利益 (EPS: 千円) *1	84	35	20	16	18	17
一株当たり純資産 (千円) *2	503	277	154	164	189	188
株価収益率 (PER: 倍) *3	5.3	16.0	14.1	17.4	11.1	11.7
株価純資産倍率 (PBR: 倍) *4	0.9	2.1	1.9	1.7	1.1	1.1
一株当たり配当金 (円) *5	13,000	13,300	5,500	6,000	6,000	—
発行済株式数 (株)	23,000	46,000	92,000	92,000	106,000	106,000
配当金 (千円)	299,000	416,300	506,000	552,000	594,000	—
配当性向 (%) *6	15.3	25.1	26.7	36.3	31.7	—
従業員一人当たり当期純利益 (千円) *7	2,681	3,147	3,410	2,725	2,539	2,453
従業員数 (人)	531	534	562	564	739	725

\*1. 一株当たり当期純利益 (EPS) = 当期純利益 ÷ 期中平均発行株式数

\*2. 一株当たり純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式数

\*3. 株価収益率 (PER) = 株価 (期末) ÷ 一株当たり当期純利益

\*4. 株価純資産倍率 (PBR) = 株価 (期末) ÷ 一株当たり純資産

\*5. 一株当たり配当金 = 配当金 ÷ 発行済株式数

\*6. 配当性向 = 配当金 ÷ 当期純利益

\*7. 従業員一人当たり当期純利益 = 当期純利益 ÷ 期末従業員数

# 会社概要

## ① 会社の概要 (2007年3月31日現在)

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	1986年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	739名(連結)
本社	神奈川県横浜市都筑区東方町1番地

## ② 役員等 (2007年6月20日現在)

### 取締役

取締役会長	古垣圭一
代表取締役社長	砂川俊昭
取締役	久我宣之
取締役	天野勝之
取締役	木村勉
取締役	徳重敦之
取締役	東哲郎
取締役	原護
取締役	常松政養

### 監査役

常勤監査役	矢崎一洋
常勤監査役	遠山憲一
監査役	田中健生
監査役	林田謙一郎

- (注) 1. 常松政養氏は、社外取締役であります。  
2. 矢崎一洋氏及び林田謙一郎氏は社外監査役であります。

### 執行役員

砂川俊昭
久我宣之
天野勝之
木村勉
徳重敦之
穴倉弘明
大崎正之
八幡浩司
武井弘治
黒田修治
山田信二
林英樹



## ③ 拠点網 (2007年4月1日現在)

本社	北関東支社宇都宮サテライト
北関東支社	大阪支社京都サテライト
大阪支社	大阪支社岡山サテライト
	大阪支社松山出張所
仙台営業所	水戸営業所
東京営業所	立川営業所
横浜営業所	長岡営業所
松本営業所	三島営業所
浜松営業所	名古屋営業所
福岡営業所	営業推進部(横浜オフィス)
	新宿オフィス
	府中オフィス
	大阪オフィス
	仙台インレビウム開発センター
	横浜インレビウム開発センター

上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス上海)  
香港華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス香港)  
無錫華桑電子科技有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス無錫)

# 株式情報

## ① 株式の状況 (2007年3月31日現在)

・発行可能株式総数	256,000株
・発行済株式の総数	106,000株
・株主数	6,009名

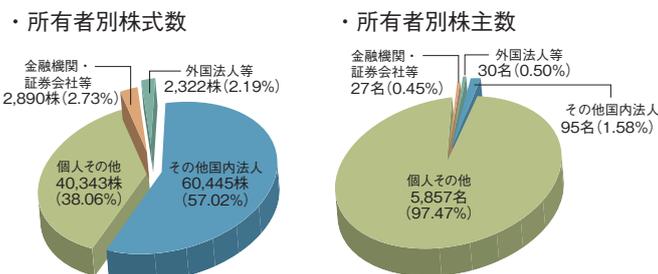
(注) 東京エレクトロン(株)のコンピュータ・ネットワーク事業を会社分割により承継したことに伴い、2006年10月1日付で同社に対し、新株14,000株を交付したことから、発行済株式の総数は、106,000株となっております。

## ② 大株主 (2007年3月31日現在)

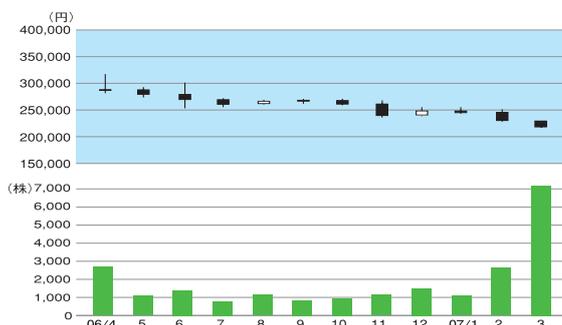
株主名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.42
東京エレクトロンデバイス社員持株会	2,901	2.73
日本証券金融株式会社	978	0.92
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	806	0.76
ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイビーシー セグリゲイテッド クライアント アカウント	795	0.75

(注) 2007年3月7日に売出人を東京エレクトロン(株)とする当社株式の売出しを実施しております。

## ③ 株式分布状況 (2007年3月31日現在)



## ④ 株価と出来高



## ■ ホームページ

当社のホームページでは、会社情報、商品情報、IR 情報など、豊富なインフォメーションを発信しています。

<http://www.teldevice.co.jp/>



トップページ



IR 情報ページ

## ■ お問い合わせ先

コーポレート企画室 TEL : 045-474-7024  
E-mail : [ir-info@teldevice.co.jp](mailto:ir-info@teldevice.co.jp)

 **東京エレクトロン デバイス株式会社**  
本社:〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町1番地  
TEL:045-474-7000(大代表) FAX:045-474-7092  
<http://www.teldevice.co.jp/>

このインベスターズガイドは再生紙を使用しております。

 PRINTED WITH SOY INK  
環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。